

# SMコンタクト

SM contact

# SM-A364030A



- 材質 /Material ..... ベリリウム銅 (t=0.1mm) Beryllium copper (t=0.1 mm)
- メッキ処理 /Plating ..... 全面: Niメッキ      Whole surface: Ni plating  
半田付部: Snメッキ      Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range ..... 高さ =2.2 ~ 3.4mm      Height: 2.2 mm to 3.4 mm

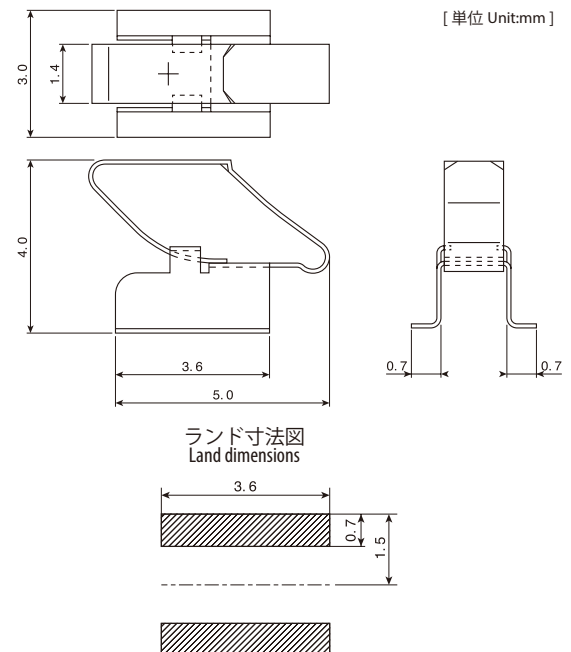
## 用途 Applications

- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。  
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

## 標準梱包数量 Standard packaging quantity

梱包形態 Packaging	数量 Quantity	備考 Remarks
テーピング Taping	2,500ヶ (リール) 2,500/reel	実数2,502ヶ (2ヶ予備) Actual quantity: 2,502 (two spares)
ダンボール Corrugated cardboard	30,000ヶ (外箱) 30,000/box	12リール/1箱 梱包 Twelve reels are packed in each box.

\* 外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。  
\* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



## 特性

## Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	測定用基盤に半田付けし、製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	2.6N以下 2.6 N or less	測定用基盤に半田付けし、製品を2.8mmに圧縮した時の反発力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 85℃ 処理時間: 500hr
耐湿試験 Humidity test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 65℃/95% RH 処理時間: 500hr
低温試験 Low temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃ 処理時間: 500hr
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 100 サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	25% 以下 25% or less	製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 12 サイクル 歪率(%)=(t0-t1)/(t0-t2) x100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペース高さ
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。 半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)の IPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。 半田温度: 245±3℃ 浸漬時間: 3 sec.

# SMコンタクト

SM contact

SM-V series

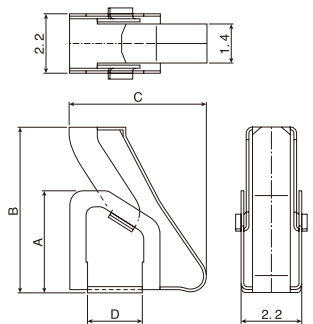


材 質 /Material ..... リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze (t = 0.1 mm)

メッキ処理 /Plating ..... 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating  
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating

推奨使用範囲 /Recommended operating range ..... SM-V384022-PB  
高さ = 2.5 ~ 3.8mm Height: 2.5 mm to 3.8 mm  
SM-V506022-PB  
高さ = 3.7 ~ 5.8mm Height: 3.7 mm to 5.8 mm

[単位 Unit:mm]

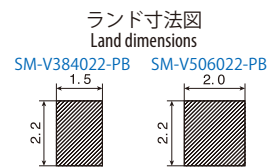


## 用途

## Applications

パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、  
家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.



## 品番表

## Product list

品番 Product code	寸法 [mm] Dimensions [mm]				標準梱包数量 Standard packaging quantity	
	A	B	C	D	テーピング Taping	ダンボール Corrugated cardboard
SM-V384022-PB	2.3	4.0	3.75	1.5	5,000ヶ (リール) /実数5,001ヶ(1ヶ予備) 5,000/reel; Actual quantity: 5,001 (one spare)	60,000ヶ (外箱) 12リール/1箱 梱包 60,000/box (12 reels are packed in each box.)
SM-V506022-PB	3.7	6.0	5.0	2.0	1,500ヶ (リール) 1,500/reel	21,000ヶ (外箱) 14リール/1箱 梱包 21,000/box (14 reels are packed in each box.)

## 特性

## Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.05Ω以下 0.05 Ω or less	測定用基盤に半田付けし、製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	1.0N以下 (SM-V384022-PB) 1.0 N or less (SM-V384022-PB) 2.6N以下 (SM-V506022-PB) 2.6 N or less (SM-V506022-PB)	測定用基盤に半田付けし、製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の反発力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 85℃ 処理時間: 500hr
耐湿試験 Humidity test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 65℃/95%RH 処理時間: 500hr
低温試験 Low temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃ 処理時間: 500hr
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 100 サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30%以下 (SM-V384022-PB) 30% or less (SM-V384022-PB) 25%以下 (SM-V506022-PB) 25% or less (SM-V506022-PB)	製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 12 サイクル 歪率(%)=(t0-t1)/(t0-t2) ×100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペース高さ
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。半田温度: 245±3℃ 浸漬時間: 3 sec.

# SMコンタクト

SM contact

# SM-485030-I



- 材 質 /Material..... リン青銅 (t=0.08mm) Phosphor bronze (t = 0.08 mm)
- メッキ処理 /Plating..... 全面: Niメッキ      Whole surface: Ni plating  
半田付部: Snメッキ      Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range ..... 高さ =2.1 ~ 4.8mm      Height: 2.1 mm to 4.8 mm

## 用 途

## Applications

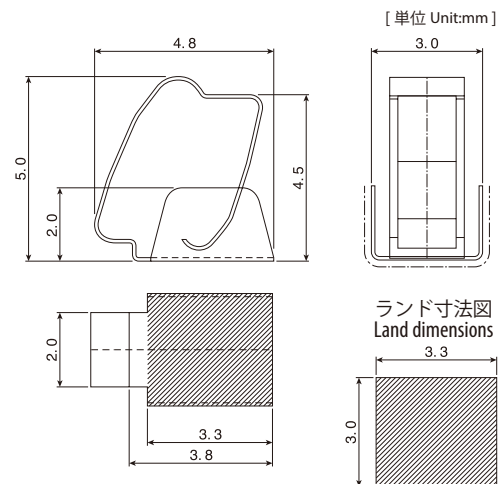
- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。  
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

## 標準梱包数量

## Standard packaging quantity

梱包形態 Packaging	数量 Quantity	備考 Remarks
テーピング Taping	2,000ヶ (リール) 2,000/reel	
ダンボール Corrugated cardboard	28,000ヶ (外箱) 28,000/box	14リール / 1箱 梱包 Fourteen reels are packed in each box.

※外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。  
\* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



## 特 性

## Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件																					
初期抵抗値 Initial resistance	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	測定用基盤に半田付けし、製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。																					
圧縮荷重 Compressive load	0.5N ~ 1.2N 以下 0.5 N to 1.2 N	測定用基盤に半田付けし、製品を4.7mm~2.7mmに圧縮した時の反発力を測定する。																					
		測定方法 製品を測定用基盤に半田付けし、製品高さを2.7mmに圧縮した時と4.7mmに圧縮した時の荷重をプッシュプルゲージを使用し手作業で測定する。																					
測定結果		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>サンプル1</th> <th>サンプル2</th> <th>サンプル3</th> <th>サンプル4</th> <th>サンプル5</th> <th>平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.7mm 時</td> <td>0.6N</td> <td>0.6N</td> <td>0.5N</td> <td>0.5N</td> <td>0.6N</td> <td>0.56N</td> </tr> <tr> <td>2.7mm 時</td> <td>1.2N</td> <td>1.1N</td> <td>1.1N</td> <td>1.2N</td> <td>1.1N</td> <td>1.14N</td> </tr> </tbody> </table>		サンプル1	サンプル2	サンプル3	サンプル4	サンプル5	平均	4.7mm 時	0.6N	0.6N	0.5N	0.5N	0.6N	0.56N	2.7mm 時	1.2N	1.1N	1.1N	1.2N	1.1N	1.14N
	サンプル1	サンプル2	サンプル3	サンプル4	サンプル5	平均																	
4.7mm 時	0.6N	0.6N	0.5N	0.5N	0.6N	0.56N																	
2.7mm 時	1.2N	1.1N	1.1N	1.2N	1.1N	1.14N																	
高温試験 High temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 85℃ 処理時間: 500hr																					
耐湿試験 Humidity test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 65℃/95% RH 処理時間: 500hr																					
低温試験 Low temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃ 処理時間: 500hr																					
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 100 サイクル																					
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30% 以下 30% or less	製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 12 サイクル 歪率(%)=(t0-t1)/(t0-t2) x100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペース高さ																					
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。 半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。 半田温度: 245±3℃ 浸漬時間: 3 sec.																					

# SMコンタクト

SM contact

## SM-Z365325-PB



- 材 質 /Material ..... リン青銅 (t=0.15mm) Phosphor bronze (t = 0.15 mm)
- メッキ処理 /Plating ..... 全面: Niメッキ      Whole surface: Ni plating  
半田付部: Snメッキ      Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range ..... 高さ = 3.4 ~ 5.0mm      Height: 3.4 mm to 5.0 mm

### 用 途

### Applications

- ▶ パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

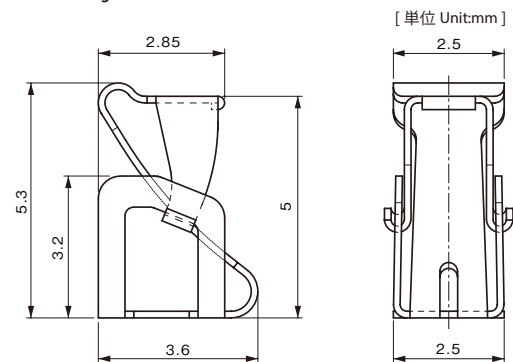
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

### 標準梱包数量

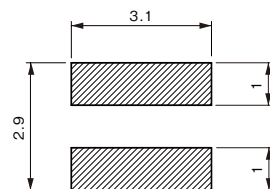
### Standard packaging quantity

梱包形態 Packaging	数量 Quantity	備考 Remarks
テーピング Taping	2,000ヶ (リール) 2,000/reel	
ダンボール Corrugated cardboard	30,000ヶ (外箱) 30,000/box	15リール/1箱 梱包 Fifteen reels are packed in each box.

※外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。  
\* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



ランド寸法図  
Land dimensions



### 特 性

### Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	測定用基板上に半田付けし、製品を4.0mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	5N以上 5 N or more	測定用基板上に半田付けし、製品を4.0mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：85℃ 処理時間：500hr
耐湿試験 Humidity test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：60℃/95%RH 処理時間：500hr
低温試験 Low temperature test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：-40℃ 処理時間：500hr
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.05 Ω以下 0.05 Ω or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：-40℃ (1hr) ~ 85℃ (1hr) 処理時間：100サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30%以下 30% or less	製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後の歪率の測定を行なう。 処理温度：-40℃ (3hr) ~ 85℃ (3hr) 処理時間：12サイクル 歪率 (%) = (t0-t1)/(t0-t2) x 100    t0：初期高さ    t1：処理後高さ    t2：スペーサー
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。 半田：PF305    フラックス：ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比率25%とする。 半田温度：245±3℃ 浸漬時間：3sec.

# SMコンタクト

SM contact

SM-D series



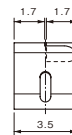
- 材 質 /Material ..... リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze (t = 0.1 mm)
- メッキ処理 /Plating ..... 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating  
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range ..... SM-D733735-PB  
高さ = 1.7 ~ 3.5mm Height: 1.7 mm to 3.5 mm  
SM-D906039-PB  
高さ = 3.5 ~ 5.8mm Height: 3.5 mm to 5.8 mm

## 用途

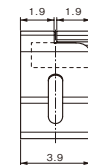
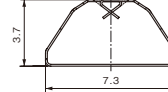
## Applications

- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、  
家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

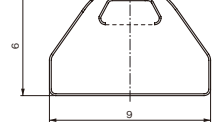
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.



SM-D733735-PB



[単位 Unit:mm]

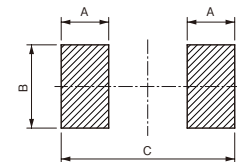


SM-D906039-PB

## 品番表

## Product list

品番 Product code	寸法[mm] Dimensions [mm]			標準梱包数量 Standard packaging quantity	
	A	B	C	テーピング Taping	ダンボール Corrugated cardboard
SM-D733735-PB	2	3.5	7.3	2,500ヶ (リール) 2,500/reel	30,000ヶ (外箱) 12リール/1箱梱包 30,000/box (12 reels are packed in each box.)
SM-D906039-PB	2	3.9	9.0	1,800ヶ (リール) 1,800/reel	21,600ヶ (外箱) 12リール/1箱梱包 21,600/box (12 reels are packed in each box.)

ランド寸法図  
Land dimensions

## 特性

## Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.01Ω以下 0.01Ω or less	測定用基板上に半田付けし、製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	5N以下 (SM-D733735-PB) 5 N or less (SM-D733735-PB) 2.2N以下 (SM-D906039-PB) 2.2 N or less (SM-D906039-PB)	測定用基板上に半田付けし、製品を2.5mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。 測定用基板上に半田付けし、製品を4.2mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.01Ω以下 0.01Ω or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: 85℃ 処理時間: 500hr
耐湿試験 Humidity test	0.01Ω以下 0.01Ω or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: 60℃/95%RH 処理時間: 500hr
低温試験 Low temperature test	0.01Ω以下 0.01Ω or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: -40℃ 処理時間: 500hr
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.01Ω以下 0.01Ω or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: -40℃ (1hr) ~ 85℃ (1hr) 処理時間: 100サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30%以下 30% or less	製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後の歪率の測定を行なう。処理温度: -40℃ (3hr) ~ 85℃ (3hr) 処理時間: 12サイクル 歪率 (%) = (t0-t1)/(t0-t2) x100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペーサー
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比率25%とする。半田温度: 245±3℃ 浸漬時間: 3sec. (SM-D733735-PB)、5sec. (SM-D906039-PB)



# SMコンタクト

SM contact

# SM-W353038-PB



- 材 質 /Material ..... リン青銅 (t=0.15mm) Phosphor bronze (t = 0.15 mm)
- メッキ処理 /Plating ..... 全面: Niメッキ      Whole surface: Ni plating  
半田付部: Snメッキ      Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range ..... 高さ = 1.4 ~ 2.8mm      Height: 1.4 mm to 2.8 mm

## 用途

## Applications

- ▶ パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

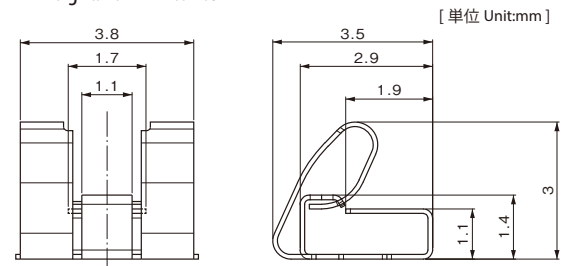
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

## 標準梱包数量

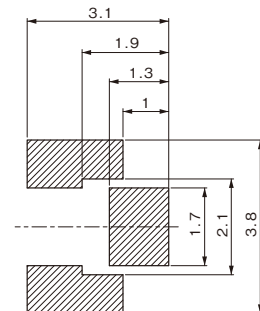
## Standard packaging quantity

梱包形態 Packaging	数量 Quantity	備考 Remarks
テーピング Taping	3,500ヶ (リール) 3,500/reel	
ダンボール Corrugated cardboard	42,000ヶ (外箱) 42,000/box	12リール/1箱 梱包 twelve reels are packed in each box.

※外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。  
\* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



ランド寸法図  
Land dimensions



## 特性

## Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.01 Ω以下 0.01 Ω or less	測定用基板上に半田付けし、製品を2.0mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	2.3N以上 2.3 N or more	測定用基板上に半田付けし、製品を2.0mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.01 Ω以下 0.01 Ω or less	製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：85℃ 処理時間：500hr
耐湿試験 Humidity test	0.01 Ω以下 0.01 Ω or less	製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：60℃/95%RH 処理時間：500hr
低温試験 Low temperature test	0.01 Ω以下 0.01 Ω or less	製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：-40℃ 処理時間：500hr
ヒートショック試験 Heat shock test	0.01 Ω以下 0.01 Ω or less	製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：-40℃ (1hr) ~ 85℃ (1hr) 処理時間：100サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30%以下 30% or less	製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後の歪率の測定を行なう。 処理温度：-40℃ (3hr) ~ 85℃ (3hr) 処理時間：12サイクル 歪率 (%) = (t0-t1)/(t0-t2) x 100    t0：初期高さ    t1：処理後高さ    t2：スペーサー
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。 半田：PF305 フラックス：ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比率25%とする。 半田温度：245±3℃ 浸漬時間：3sec.